

序号	测试项目	缩写	检测方法
A组 加速环境应力测试			
A1	预处理	PC	J-STD-020 JESD22-A113
A2	有偏温湿度或有偏高加速应力测试	THB/HAST	JESD22-A101 JESD22-A110
A3	高压或无偏高加速应力测试或无偏温湿度测试	AC/ UHST /TH	JESD22-A102 JESD22-A118 JESD22-A101
A4	温度循环	TC	JESD22-A104
A5	功率负载温度循环	PTC	JESD22-A105
A6	高温储存寿命测试	HTSL	JESD22-A103
B组 加速寿命模拟测试			
B1	高温工作寿命	HTOL	JEDEC JESD22-A108
B2	早期寿命失效率	ELFR	AEC Q100 -008
B3	非易失性存储器耐久	EDR	AEC Q100 -005
C组 封装组合完整性测试			
C1	绑线剪切	WBS	AEC-Q100-001
C2	绑线拉力	WBP	MIL-STD 883 Method2011
C3	可焊性	SD	JESD22-B102
C4	物理尺寸	PD	JESD22-B100 JESD22-B108
C5	锡球剪切	SBS	AEC-Q100-010
C6	引脚完整性	LI	JESD22-B105
D组 芯片晶圆可靠度测试			
D1	电迁移	EM	/
D2	经时介质击穿	TDDDB	/
D3	热载流子注入	HCI	/
D4	负偏压温度不稳定性	NBTI	/
D5	应力迁移	SM	/
E组 电气特性确认测试			
E1	应力测试前后功能参数测试	TEST	规格书
E2	静电放电 (HBM)	HBM	AEC-Q100-002
E3	静电放电 (CDM)	CDM	AEC-Q100-011
E4	闩锁效应	LU	AEC-Q100-004
E5	电分配	ED	AEC-Q100-009
E6	故障等级	FG	AEC-Q100-007
E7	特性描述	CHAR	AEC-Q003
E9	电磁兼容	EMC	SAE J1752/3
E10	短路特性描述	SC	AEC-Q100-012
E11	软误差率	SER	JESD89-1 JESD89-2 JESD89-3
E12	无铅 (Pb)	LF	AEC-Q005
F组 缺陷筛选测试			
F1	过程平均测试	PAT	AEC-Q001
F2	统计良率分析	SBA	AEC-Q002
G组 腔体封装完整性测试			
G1	机械冲击	MS	JESD22-B104
G2	变频振动	VFV	JESD22-B103
G3	恒加速	CA	MIL-STD-883 Method2001
G4	粗细气漏测试	GFL	MIL-STD-883 Method1014
G5	包装跌落	DROP	/
G6	盖板扭力测试	LT	MIL-STD-883 Method2024
G7	芯片剪切	DS	MIL-STD-883 Method2019
G8	内部水汽含量测试	IWW	MIL-STD-883 Method1018